表面探傷スコープ™ (Surface Flaw Detection Scope ™)

参考出品

東芝特許技術「OneShotBRDF®」使用

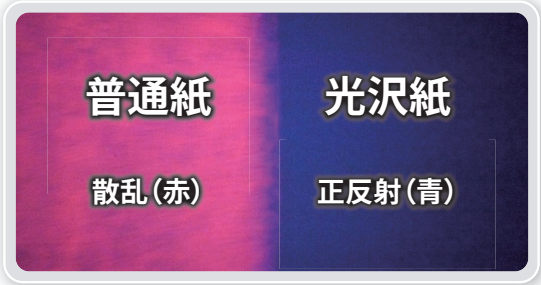
表面探傷スコープ™

特長

1: フラット面に付いた観測困難な微小傷を可視化
2: 多波長同軸開口による散乱光識別で高速検査
3: 画像識別困難なキズでも色で識別

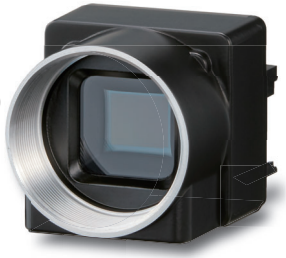
仕様 (参考値)

:: 測定視野： 50mm × 50mm
:: 最小傷： 数10μm



搭載カメラ: BU2409MCF

1: 撮像デバイス： Sony製 IMX540
2: 解像度： 2,447万画素 (5,320×4,600画素)
3: 画素サイズ： 2.74μm × 2.74μm
4: インターフェース： USB3.1 Gen.1



※ OneShotBRDFは、東芝情報システム株式会社の登録商標です。

東芝テリー株式会社